

2017-2022年中国晶圆代工 市场分析预测及前景趋势报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国晶圆代工市场分析预测及前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/C97161W1G8.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章 晶圆制造简介	21
第一节 晶圆制造流程	21
第二节 晶圆制造成本分析	27
第二章 半导体市场	32
第一节 2017-2022年半导体产业预测	32
第二节 2016年半导体市场下游预测	34
第三节 全球晶圆代工产业现状	35
第四节 全球半导体制造产业	38
一、全球半导体产业概况	38
二、全球晶圆代工行业概况	39
第五节 中国半导体产业与市场	44
一、中国半导体市场	44
二、中国半导体产业	47
三、中国ic设计产业	56
四、中国半导体产业发展趋势	59
第三章 晶圆代工产业简介 (ZY LII)	61
第一节 晶圆制造工艺简介	61
第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介	62
第三节 中国半导体产业政策环境	70
第四节 中国晶圆制造业现状及预测	73
第四章 晶圆厂研究	76
一、中芯国际	76
（一）企业偿债能力分析	77
（二）企业运营能力分析	79
（三）企业盈利能力分析	82
二、上海华虹nec电子有限公司	83
（一）企业偿债能力分析	85

(二) 企业运营能力分析	87
(三) 企业盈利能力分析	90
三、上海宏力半导体制造有限公司	92
(一) 企业偿债能力分析	93
(二) 企业运营能力分析	95
(三) 企业盈利能力分析	98
四、华润微电子	99
(一) 企业偿债能力分析	100
(二) 企业运营能力分析	102
(三) 企业盈利能力分析	105
五、上海先进半导体	106
(一) 企业偿债能力分析	107
(二) 企业运营能力分析	109
(三) 企业盈利能力分析	112
六、和舰科技(苏州)有限公司	113
(一) 企业偿债能力分析	114
(二) 企业运营能力分析	116
(三) 企业盈利能力分析	119
七、bcd(新进半导体)制造有限公司	120
(一) 企业偿债能力分析	121
(二) 企业运营能力分析	123
(三) 企业盈利能力分析	126
八、方正微电子有限公司	127
(一) 企业偿债能力分析	128
(二) 企业运营能力分析	130
(三) 企业盈利能力分析	133
十、南通绿山集成电路有限公司	134
(一) 企业偿债能力分析	135
(二) 企业运营能力分析	137 (ZY LII)
(三) 企业盈利能力分析	140

图表目录：

图表 1 晶圆制造工艺流程 21

图表 2 晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析 27

图表 3 2016年度全球营收前13的晶圆代工企业 35

图表 4 2017-2022年大陆ic内需市场规模变化与预测 36

图表 5 主要代工企业产能分布及收益情况 41

图表 6 集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用 43

图表 7 全球半导体市场规模超过3000亿美元 47

图表 8 半导体产品种类繁多 48

图表 9 全球半导体分产品市场占比 48

图表 10 中国大陆半导体市场规模近4000亿元 49

图表 11 全球半导体产业区域结构发生巨大变化 50

图表 12 北美半导体设备制造商bb 值 51

图表 13 半导体产业链 51

图表 14 近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商 52

图表 15 半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低 53

图表 16 封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒 54

图表 17 集成电路封测行业一直占据行业主导地位 55

图表 18 国内十大半导体封装测试企业 56

图表 19 2016年全球晶圆代工排名 63

图表 20 2012-2016年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势 64

图表 21 全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较 65

图表 22 前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势 66

图表 23 全球半导体厂商资本支出集中程度分析 67

图表 24 半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析 68

图表 25 全球半导体设备产业版图的变化 69

图表 26 国内政策对集成电路产业大力支持 71

图表 27 国内半导体进口金额超2000亿美元 71

图表 28 国内集成电路未来三阶段发展目标 73

图表 29 近3年中芯国际有限公司资产负债率变化情况 77

图表 30 近3年中芯国际有限公司产权比率变化情况 78

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/C97161W1G8.html>